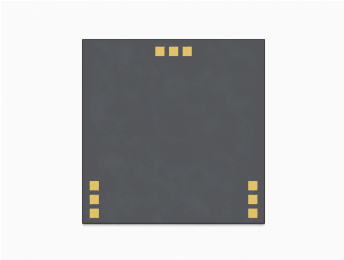


## 2000–18000 MHz Die divisore di potenza GaAs IPD a 2 vie e 0°

Isolamento: 20 dB (tipico); VSWR di ingresso: 1.3 (tipico); VSWR di uscita: 1.3 (tipico). Dimensioni del die: 2 × 2 × 0.1 mm.



### Caratteristiche RF · TA = +25 °C

| Parametro           | Simbolo | Minimo | Tipico | Massimo | Valore     | Unità |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|------------|-------|
| Frequenza operativa | -       | 2000   | -      | 18000   | 2000–18000 | MHz   |
| Isolamento          | -       | -      | 20     | -       | -          | dB    |
| VSWR di ingresso    | -       | -      | 1.3    | -       | -          | -     |
| VSWR di uscita      | -       | -      | 1.3    | -       | -          | -     |

### Valori limite

| Parametro                   | Simbolo | Minimo | Tipico | Massimo | Unità |
|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|-------|
| Potenza di ingresso massima | -       | -      | -      | 30      | dBm   |

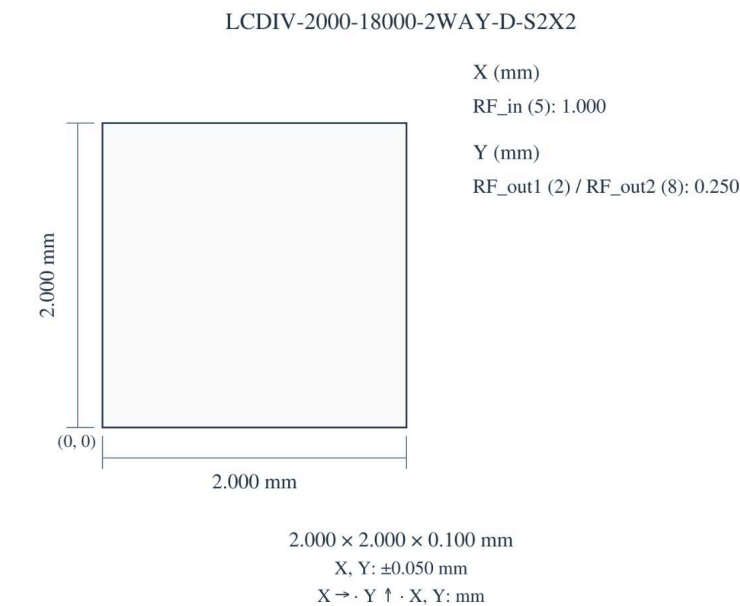
### Condizioni ambientali

| Parametro                 | Simbolo | Minimo | Tipico | Massimo | Unità |
|---------------------------|---------|--------|--------|---------|-------|
| Temperatura di stoccaggio | -       | -65    | -      | 150     | °C    |
| Temperatura operativa     | -       | -55    | -      | 85      | °C    |

Dimensioni del die

| Parametro          | Valore                  | Unità |
|--------------------|-------------------------|-------|
| Dimensioni del die | $2 \times 2 \times 0.1$ | mm    |

Disegno dimensionale meccanico



Tutte le dimensioni sono espresse in mm [in].

Assegnazione delle piazzole di bonding

| Terminali        | Simbolo | Funzione                      | Note |
|------------------|---------|-------------------------------|------|
| 1, 3, 4, 6, 7, 9 | GND     | Massa; bonding non necessario | -    |
| 2                | RFout1  | Uscita RF                     | 1    |
| 8                | RFout2  | Uscita RF                     | 2    |
| 5                | RFin    | Ingresso RF                   | -    |

**Publicazione corrente** · 1.3 · 2026-10-27. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.2.

Ambito del riferimento meccanico

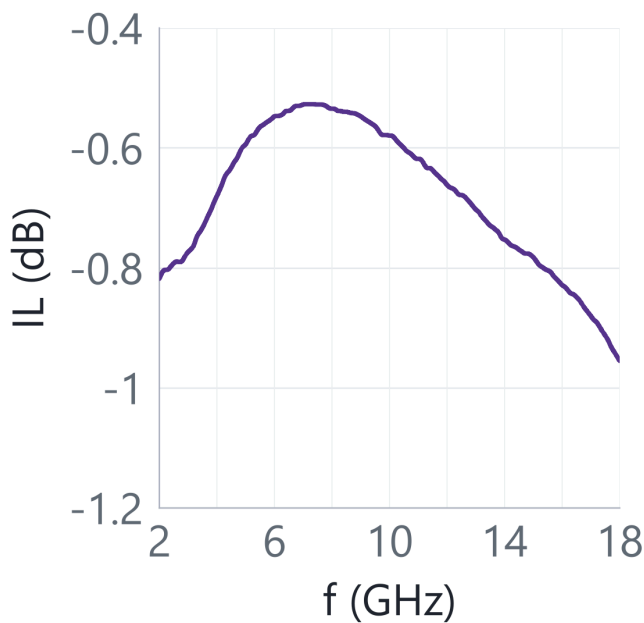
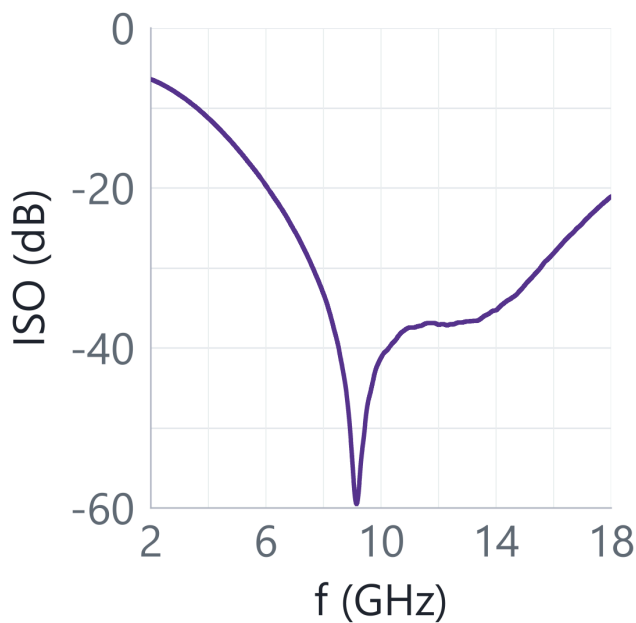
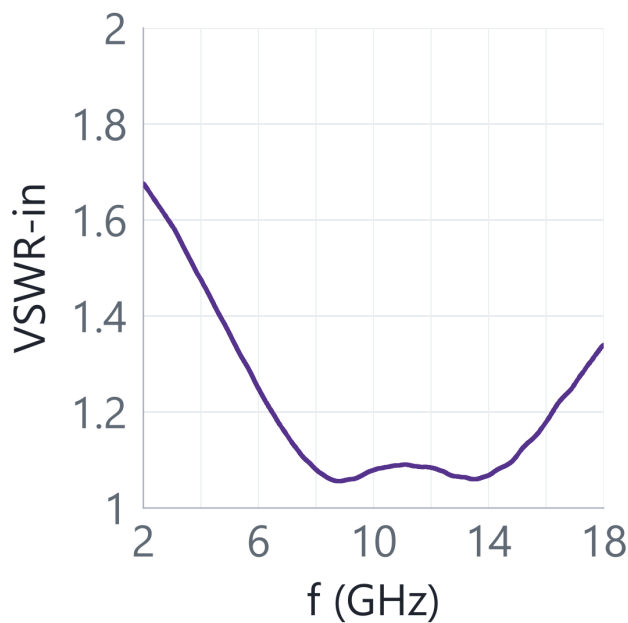
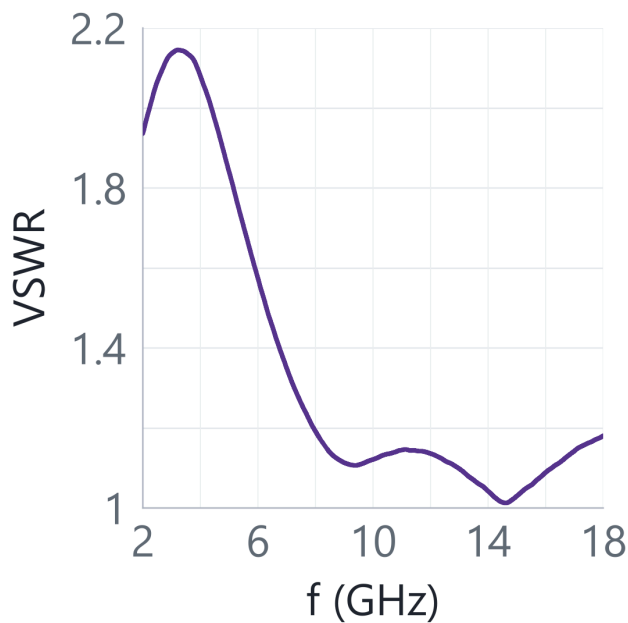
Riferimenti dimensionali in mm ricavati dalla documentazione di origine. Informazioni parziali; non costituiscono un disegno completo di fabbricazione o di wire bonding.

Curve di prestazione

Grafici tratti dalla scheda tecnica originale. Consultare ogni figura insieme alle condizioni operative indicate.

Perdita di inserzione; Isolamento; Adattamento d’ingresso; VSWR.

Grafico ridisegnato dalla figura originale; i valori letti sono approssimativi. Le diciture del secondo grafico di VSWR nella fonte sono in conflitto: il titolo indica l’uscita, mentre l’asse verticale riporta VSWR\_in. L’attribuzione alla porta non è confermata.



[Fonte](#)

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.